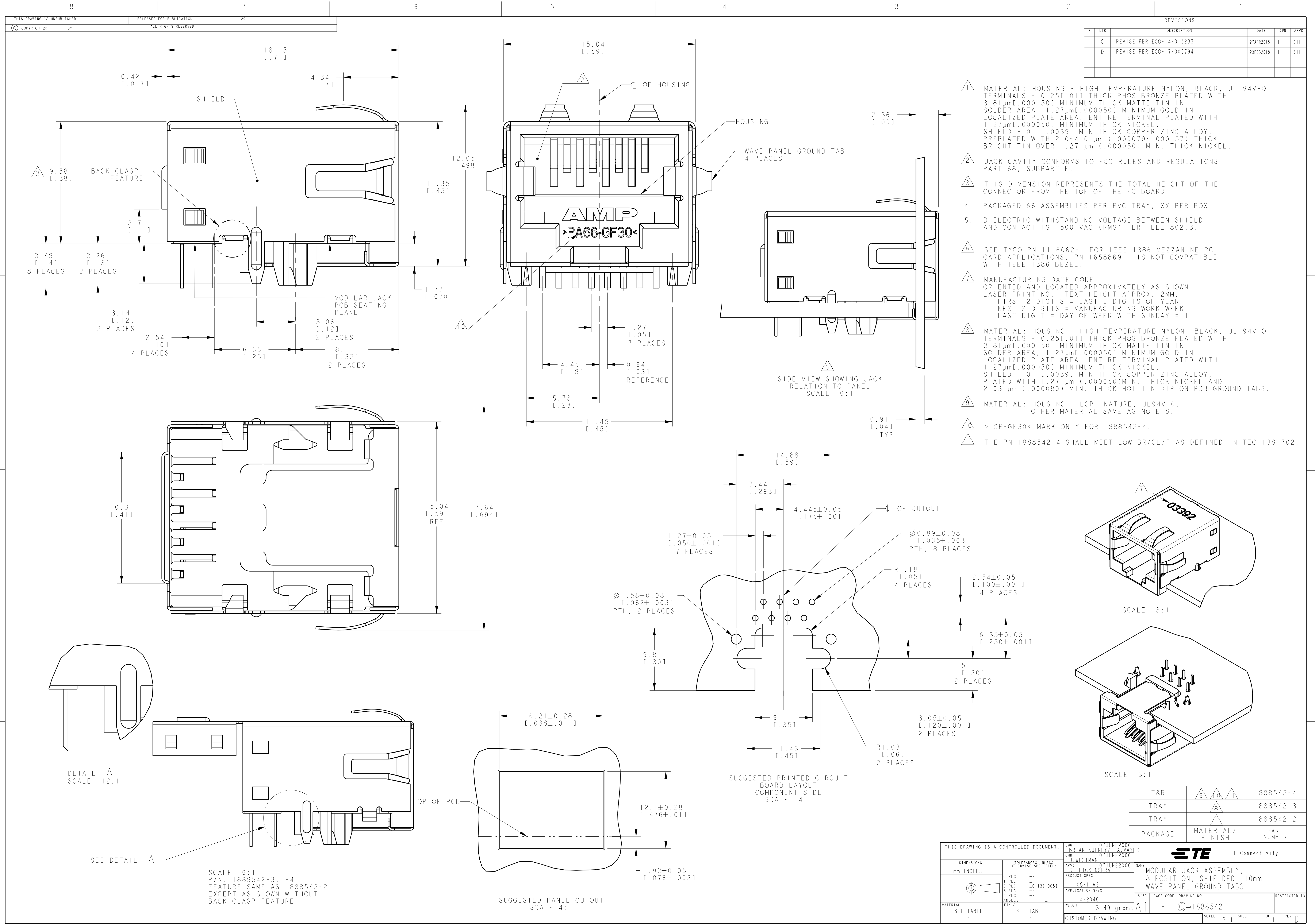
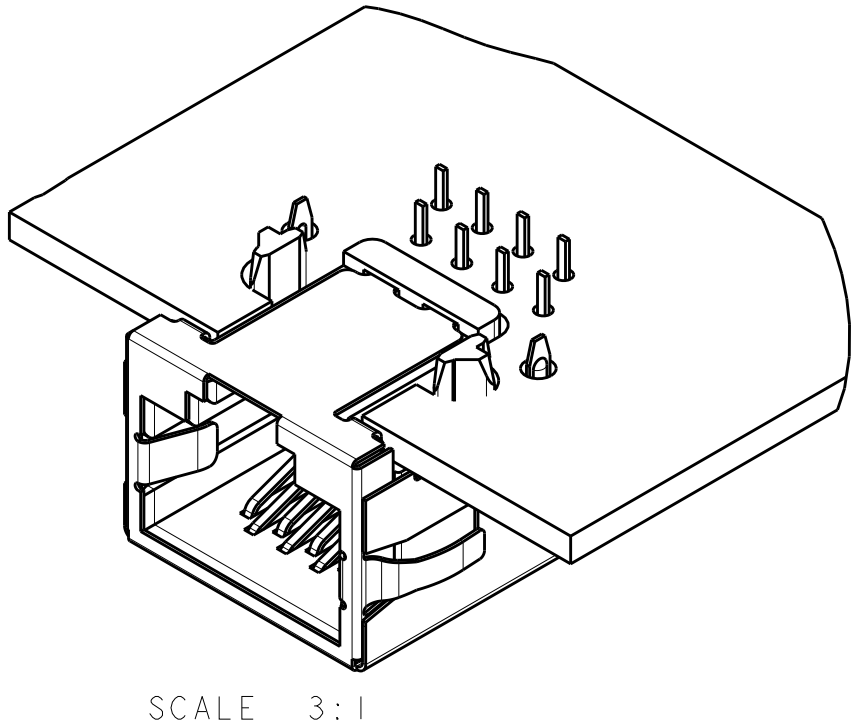
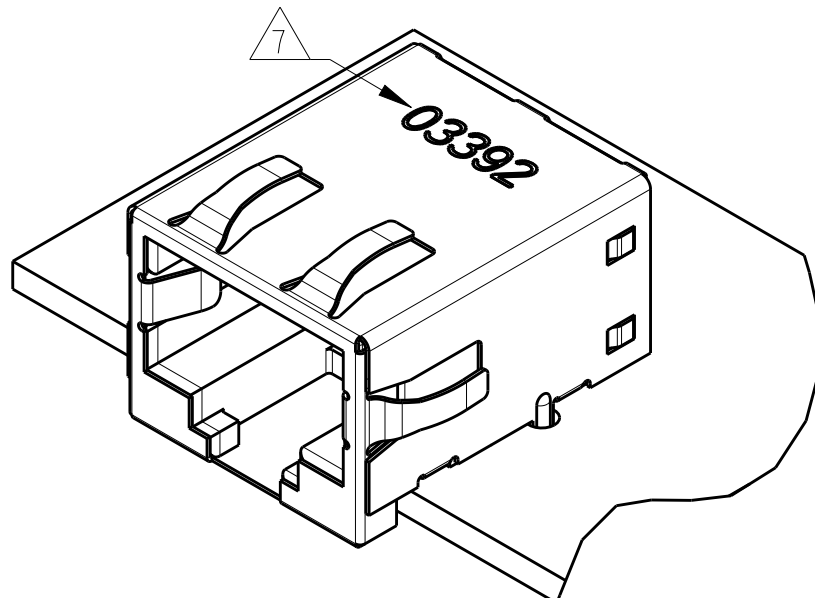




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
C		REVISE PER ECO-14-015233	27APR2015	LL	SH
D		REVISE PER ECO-17-005794	23FEB2018	LL	SH

- △ MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE NYLON, BLACK, UL 94V-0
TERMINALS - 0.25[.01] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH
3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN
SOLDER AREA, 1.27 μ m[.000050] MINIMUM GOLD IN
LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH
1.27 μ m[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD - 0.1[.0039] MIN THICK COPPER ZINC ALLOY,
PREPLATED WITH 2.0~4.0 μ m (.000079~.000157) THICK
BRIGHT TIN OVER 1.27 μ m (.000050) MIN. THICK NICKEL.
- △ JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS
PART 68, SUBPART F.
- △ THIS DIMENSION REPRESENTS THE TOTAL HEIGHT OF THE
CONNECTOR FROM THE TOP OF THE PC BOARD.
4. PACKAGED 66 ASSEMBLIES PER PVC TRAY, XX PER BOX.
5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE BETWEEN SHIELD
AND CONTACT IS 1500 VAC (RMS) PER IEEE 802.3.
- △ SEE TYCO PN 1116062-1 FOR IEEE 1386 MEZZANINE PCI
CARD APPLICATIONS. PN 1658869-1 IS NOT COMPATIBLE
WITH IEEE 1386 BEZEL.
- △ MANUFACTURING DATE CODE:
ORIENTED AND LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
LASER PRINTING. TEXT HEIGHT APPROX. 2MM.
FIRST 2 DIGITS = LAST 2 DIGITS OF YEAR
NEXT 2 DIGITS = MANUFACTURING WORK WEEK
LAST DIGIT = DAY OF WEEK WITH SUNDAY = 1
- △ MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE NYLON, BLACK, UL 94V-0
TERMINALS - 0.25[.01] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH
3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN
SOLDER AREA, 1.27 μ m[.000050] MINIMUM GOLD IN
LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH
1.27 μ m[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD - 0.1[.0039] MIN THICK COPPER ZINC ALLOY,
PLATED WITH 1.27 μ m (.000050) MIN. THICK NICKEL AND
2.03 μ m (.000080) MIN. THICK HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.
- △ MATERIAL: HOUSING - LCP, NATURE, UL94V-0.
OTHER MATERIAL SAME AS NOTE 8.
- △ >LCP-GF30< MARK ONLY FOR 1888542-4.
- △ THE PN 1888542-4 SHALL MEET LOW BR/CL/F AS DEFINED IN TEC-138-702.



T&R	△9△0△1	1888542-4
TRAY	△8	1888542-3
TRAY	△1	1888542-2
PACKAGE	MATERIAL / FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: 07JUNE2006 CHK: BRIAN KUHN J. WESTMAN S. FLOCKINGER APVD: 07JUNE2006	NAME: MODULAR JACK ASSEMBLY, 8 POSITION, SHIELDED, 10mm, WAVE PANEL GROUND TABS	
DIMENSIONS: mm[INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC: 108-1163	SIZE: A1	RESTRICTED TO: D
MATERIAL: SEE TABLE	FINISH: SEE TABLE	APPLICATION SPEC: 114-2048	WEIGHT: 3.49 grams	REV: D
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 3:1 SHEET 1 OF 1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9